

附表五 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業放流水水質項目及限值

| 項目 | | 限值 | 備註 | |
|--------------------|-----------------------------|--|------------------|---|
| 水溫 | 排放於非海洋之地面水體者 | 攝氏三十八度以下 (適用於五月至九月) | | |
| | | 攝氏三十五度以下 (適用於十月至翌年四月) | | |
| | 直接排放於海洋者 | 放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 | | |
| 氫離子濃度指數 | | 六·0—九·0 | | |
| 氟鹽 | | 一五 | | |
| 硝酸鹽氮 | | 五0 | | |
| 氨氮 | 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業 | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一0 | |
| | | 金屬表面處理業、電鍍業 | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 |
| | | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 一五0 一二0 六0 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 自中華民國一百一十三年一月一日施行。 自中華民國一百一十六年一月一日施行。 |
| | | | 二0 | |
| 正磷酸鹽 (以三價磷酸根計算) | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 四·0 | | |
| 酚類 | | 一·0 | | |
| 陰離子界面活性劑 | | 一0 | | |
| 氰化物 | | 一·0 | | |

| | | | |
|------------|--|------|-------------------|
| 油脂（正己烷抽出物） | | —0 | |
| 溶解性鐵 | | —0 | |
| 溶解性錳 | | —0 | |
| 鎘 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0·0三 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 0·0二 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 0·0二 | |
| 鉛 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | —·0 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 0·五 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 0·五 | |
| 總鉻 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二·0 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 一·五 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 一·五 | |
| 六價鉻 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0·五 | |

| | | | |
|---|--|------|------------------|
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 0·三五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 0·三五 | |
| 銅 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三·0 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 一·五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 一·五 | |
| 鋅 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五·0 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 三·五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 三·五 | |
| 鎳 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一·0 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 0·七 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |

| | | | |
|----|--|-----------------|-------------------|
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 0.七 | |
| 砷 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0.五 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 0.三五 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 0.三五 | |
| 砷 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0.五 | |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 0.三五 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 0.三五 | |
| 錫 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業 | 二.0 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 一.0 | |
| 總汞 | | 0.00五 | |
| 銀 | | 0.五 | |
| 硼 | 金屬基本工業、印刷電路板製造業 | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一.0 |
| | | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 五.0 |
| | 金屬表面處理業、電鍍業 | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一.0 |
| | | 排放於自來水水質 | 一二 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|---------|-------|-------------------|
| | | 水量保護區外者 | —0 | 自中華民國一百十三年一月一日施行。 |
| | | | 五.0 | 自中華民國一百十六年一月一日施行。 |
| 鉬 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | | 0.六 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
| | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | | 0.六 | |
| 硫化物 | | | — . 0 | |
| 化學需氧量 | 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業 | | —00 | |
| | 印刷電路板製造業 | | —二0 | |
| 懸浮固體 | 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業 | | 三0 | |
| | 印刷電路板製造業 | | 五0 | |
| 生化需氧量 | 印刷電路板製造業 | | 五0 | |